

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“惠柏新材”）于2025年2月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、授信情况概述

为满足公司业务发展的需要，公司2025年度拟向相关商业银行申请一年期综合授信额度52,000.00万元，用于办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款、保理e融、商业承兑汇票贴现等综合业务，具体拟向各商业银行申请的额度如下：

申请主体	授信银行	2025年授信额度 (单位: 万元)	担保条件
惠柏新材	招商银行股份有限公司上海宜山支行	15,000.00	无，纯信用
惠柏新材	兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	25,000.00	
惠柏新材	杭州银行股份有限公司上海分行	4,000.00	
惠柏新材	宁波银行股份有限公司上海分行	8,000.00	

具体授信方案以银行实际审批通过结果为准，公司董事会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。

### 二、本次交易目的和对公司的影响

公司向相关商业银行申请授信额度是基于公司2025年度的实际业务发展需要，有利于缓解公司的资金压力，有利于公司业务的开展，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不存在违反相关法律、法规的情形。

### 三、备查文件

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年2月28日